

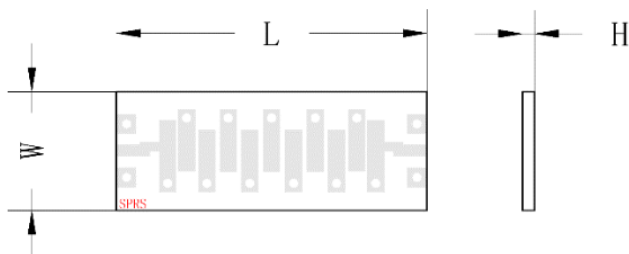
产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

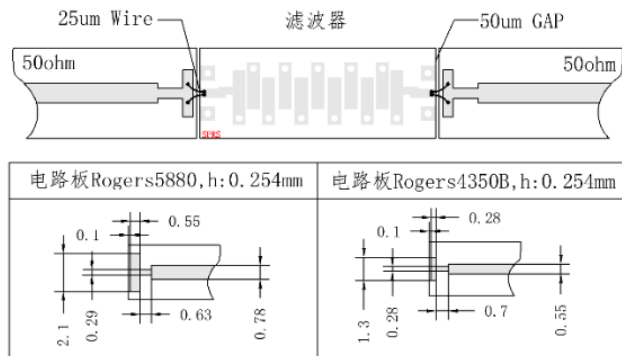
技术要求, $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		14.125		GHz
工作频率	13.75		14.5	GHz
通带损耗			5.0	dB
带内波动			1.0	dB
VSWR			1.7	
带外抑制@13.05GHz	30			dBc
带外抑制@15.15GHz	30			dBc
承受功率			30	dBm
工作温度	-45		+50	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 9.0, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



推荐装配图:

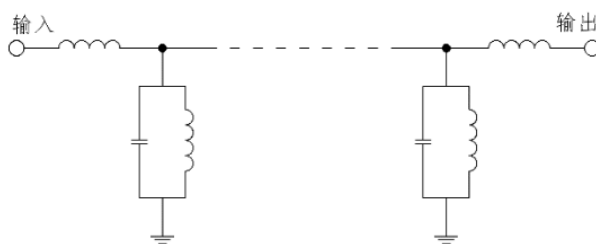


注意事项:

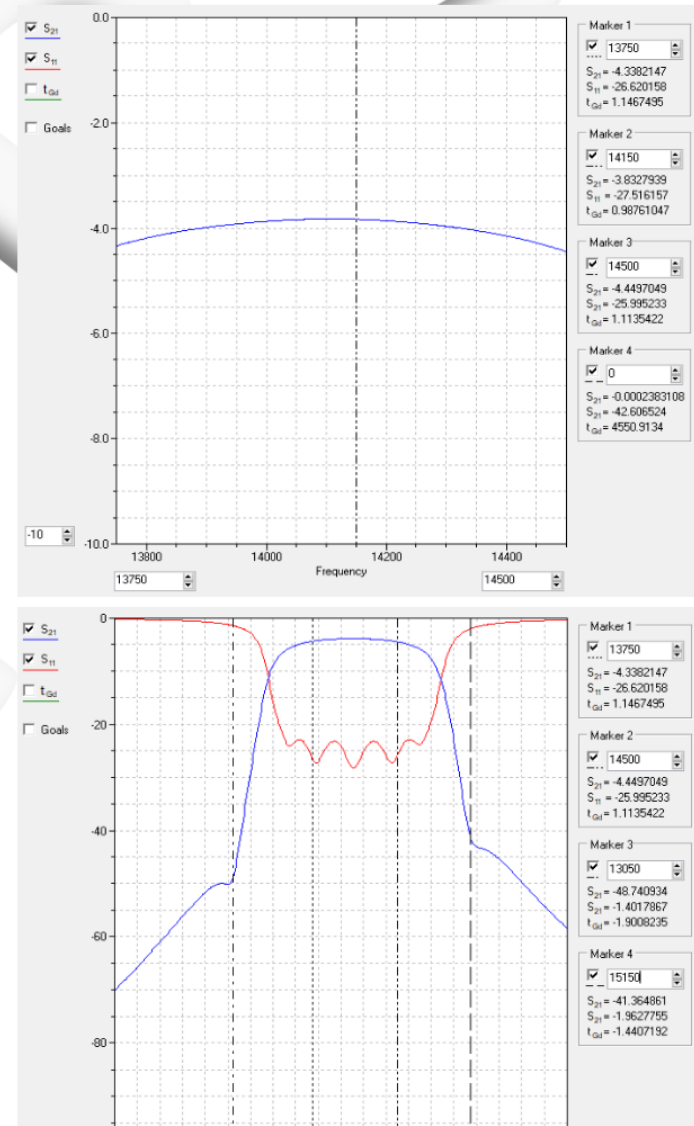
1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁0.1mm，表面距上盖2.75mm，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$)载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$;

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

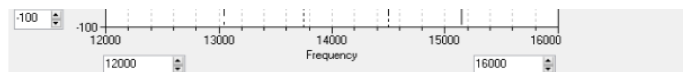
原理图



典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$



4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配；



Tel:18349127722

Fax:+86 28-80566718

Email:pengxiaojun@cdsprs.com

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

官网 www.com-mw.com

商城 www.dianzibuy.com

电话 15608095669

邮箱 sales@com-mw.com